

2024第六届国际半导体技术及应用展览会SEMI-e

产品名称	2024第六届国际半导体技术及应用展览会SEMI-e
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会(展会简称: SEMI-e)是由中国通信工业协会、深圳市半导体行业协会、深圳市中新材会展有限公司、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、成都市集成电路行业协会等单位联合主办。第六届SEMI-e以[“芯”中有“算”.智享未来]为主题,60,000平方米展出面积,800余家展商,预计观众人数达60,000+。本届展会展示以芯片设计及制造、半导体制造、封测、材料和设备、零部件及检测外,突出AI算力、算法、存储、工业控制、汽车智能化、物联网、Ai医疗、教育、智慧能源控制等各种新应用解决方案。

上届SEMI-e展览面积超40,000m,集结643家展商,展品涵盖电子元器件、IC设计&芯片、晶圆制造及封装、Mini/Micro-LED、半导体设备、半导体材料、第三代半导体7大领域,同期举办40+主题活动,吸引来自半导体行业、汽车新能源、消费电子、医疗和工控等领域40,757人到场参观交流,累计73,646参观人次。长电科技、华天科技、通富微电、华进半导体、捷捷微电、江波龙、比亚迪、三环集团、时创意、金泰克、敦泰科技、合科泰、沛顿、无锡芯享、英诺赛科、基本半导体、镓未来、天域半导体、烁科晶体、瀚天天成、河北普兴、森国科、镓未来、江苏能华微、聚能创芯、晟光硅研、上海微电子装备、华工激光、凯格精机、新益昌开玖、劲拓/思立康、宇环数控、联得半导体、基恩士、高视、视清科技、猎奇智能、正业科技、埃芯、汉虹精密、纳设智能、思泰克、恩纳基、明治传感器、THK、华卓精科、森美协尔等企业均在本届展会中全面展示了半导体行业的新技术、新产品、新亮点、新趋势,构建起半导体产业交流融合的新生态。

其中,安世半导体、比亚迪半导体、富士康、华为、嘉德新能源、亚科电子、中兴通讯、长安新科等企业组团莅临现场,另有扬杰科技、东微半导体、斯达半导体、中芯国际、英飞凌、中车时代、天科合达、长江存储、华润微、广汽集团、英特尔、微软中国、腾讯、比亚迪、安森美、神龙汽车、小米汽车、一汽丰田、寒武纪、紫光展锐、中芯微、地平线、中科芯(中电第五十八研究所)、兆易创新、华润微电子、华虹、圣邦微、新洁能、集创北方、TCL华星、三安光电、中车时代、天科合达、士兰微、日月光、平头哥、意法半导体、--汽大众、索尼、OPPO、中国电建集团江西电建、天岳先进、时代电气等买家代表

均莅临本届展会,零距离探秘科技魅力,助力半导体行业的创新发展。

5G&半导体产业技术高峰会

围绕半导体材料产业链多元化发展与技术创新,邀请半导体制造材料、原材料各环节和企业代表进行交流分享。

第四届第三代半导体产业发展高峰论坛

汇聚第三代半导体和企业代表,围绕热点应用、技术研发、重点产品和机遇挑战等热点话题,展示关于第三代半导体的产业现状、发展路径、未来趋势和资本动向。

人工智能芯片发展大会

邀请来自学术界、工业界以及zhengfu机构的专家学者,探讨人工智能芯片领域的新进展和未来趋势,促进人工智能芯片技术的创新和发展,提高人工智能芯片产业的竞争力和创新力。

国际电源技术产业高峰论坛

聚焦中国电源产业、高端及关键性科研成果、新技术和新产品,助力展商和观众了解更多关于电源技术相关资讯和新趋势。

TWS耳机产业高峰技术论坛

聚焦智能音频产业,围绕耳机产品解决方案和发展方向,展示智能耳机与数字音频的与产业动态,促进音频产业链的健康发展。

2024第六届SEMI-e展会亮点

年度行业盛会

作为华南区具影响力的半导体展,本届展会预计将吸引超过800余家企业参展,集中展示集成电路、电子元器件、第三代半导体及产业链材料和设备为一体的半导体产业链。展会为企业达成贸易合作和市场开发双向赋能,加强生产研发销售三端互动,为参会企业和观众深入洞悉半导体市场未来发展新风向提供全方位的服务和参考。

高峰论坛引领产业趋势

同期举办多场论坛,主题覆盖集成电路芯片设计、半导体材料、5G应用、智能消费电子、汽车电子、无线充电等领域话题,汇聚专家大咖探讨行业发展趋势,资讯分享和热点互动。

商业配对

展会平台对接服务全新升级,主办方在展前联系有明确caigou需求和供应商储备需求的VIP特邀买家,挖掘明确caigou需求快速锁定展商,提高您的社交精度。诚邀来自线上线下的半导体行业用户caigou负责人,-对一见面洽谈。

百家媒体宣传报道

SEMI-e注重对展商企业品牌的塑造和推广，在消费类电子、智能制造、物联网、汽车电子、手机、数码产品、LED照明、集成电路、5G+、半导体等领域的全媒体矩阵将在展前、展中以及展后进行持续的全方位、多角度、立体化的宣传报道。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、储存器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等